國立勤益科技大學 114 學年度 日間部四年制 機械工程系 學分計畫表機械工程系 國際學生產學合作專班 National Chin-Yi University of Technology Curriculum Planning for 2025 Four-Year Bachelor Industry-Academia Collaboration Program for International Students: Department of Mechanical Engineering

113.10.23 系課程及 113.11.13 系務會議審議通過 113.11.19.院課程會議審議通過

113.12.5.校課程委員會議及 113.12.24.臨時教務會議審議通過

			期 First Sei			Second Se	Semester					
科目	Courses	學分	正課	實習	學分	正課	實習					
	共同必修科目(32 學分) General Required Co	Credits	Lecture	Practice	Credits	Lecture	Practice					
第一學年First Year												
英文聽與說(一)	English Listening and Speaking (I)	3	3	0								
華語聽說(一)	Chinese Listening and speaking (I)	3	5	0								
華語讀寫(一)	Chinese Reading and writing (I)	3	5	0								
華語輔導課程	Extracurricular Chinese Class	0	5	0								
體育(一)	Physical Education (I)	0	2	0								
華人文化與生活	Chinese Culture and Life	2	2	0								
音樂鑑賞	Music Appreciation	1	1	0								
藝術鑑賞	Art Appreciation	1	1	0								
華語聽說(二)	Chinese Listening and speaking (II)				3	5	0					
華語讀寫(二)	Chinese Reading and writing (II)				3	5	0					
英文聽與說(二)	English Listening and Speaking (II)				3	3	0					
體育(二)	Physical Education (II)				0	2	0					
微積分	Calculus				3	3	0					
	第二學年Second Year	_										
人權與法治	Human Rights and Rule of Law	2	2	0								
華語聽說(三)	Chinese Listening and speaking (Ⅲ)	3	3	0								
職場倫理與生涯規劃	Work Place Ethics and Career Plan	2	2	0								
	專業必修科目(69 學分) Department Required (Courses (69c	redits)									
To me I by a tole 1 by the local	第一學年First Year	1	1	1	1 -							
電腦輔助機械製圖	Computer Aided Mechanical Drawin				3	1	2					
静力學	Statics				3	3	0					
產業發展概論	Introduction to Industrial Development				3	3	0					
李 1 x 1	第二學年Second Year	1 2	1 2	1 0	I	1	ı					
製造學	Manufacturing Processes	3	3	0								
材料力學	Mechanics of Materials	3	3	0								
數控工具機	CNC Machine Tool	3	1	2								
程式語言	Programming Language	3	1	2								
半導體製程概論	Introduction to Semiconductor Manufacturing Processes	3	3	0								
電機學與實習	Electrical Machinery and Practice	3	1	2								
機構學	Mechanism				3	3	0					
半導體設備概論	Introduction to Semiconductor Equipment				3	3	0					
工程材料與實習	Engineering Material and Practice				3	1	2					
產業實務實習(一)	Industry Internship (I)				9	0	9					
	第三學年Third Year											
產業實務實習(二)	Industry Internship (II)	9	0	9								
應用熱傳學	Applied Heat Transfer	3	3	0								
電腦輔助設計	Computer Aided Design	3	1	2								
精密量具檢驗	Precision Measuring Test	3	1	2								
電腦輔助製造	Computer Aided Manufacturing				3	1	2					
1). # 4/2 da aba ab	第四學年 Fourth Year	1 -			ı	1						
機電整合與實習	Mechatronics Theory and Practice	3	1	2								

		上學:	期 First Ser	nester	下學期 Second Semester							
科目	Courses	學分	正課	實習	學分	正課	實習					
		Credits	Lecture	Practice	Credits	Lecture	Practice					
	專業選修科目 Professional Electives (Courses	-									
	第一學年First Year											
(無排定專業選修課程 No Professional Electives Courses)												
第二學年Second Year												
	(無排定專業選修課程 No Professional Elect	tives Cours	es)									
	第三學年 Third Year											
校外實習(一)	Extracurricular Internship (I) 6 0											
自動化機構設計 Automatic Machine System Design 3												
沖壓模設計 Stamping Die Design 3 3												
逆向工程與快速原型技術 Reverse Engineering and Rapid Prototyping 3 3												
塑膠模具設計	Plastics Mold Design				3	3	0					

半導體材料與檢測分析	Semiconductor Materials and Detection Analysis				3	3	0			
第四學年Fourth Year										
自動化量測	Automated Measurement	3	0							
綜合加工機技術概論	Introduction to Comprehensive Processing Machine Technology	3	3	0						
人因工程	Human Factor Engineering	3	3	0						
電腦繪圖證照班	Computer Aided Graphics Certification Class	3	3	0						
工業設計	Design of Industrial	3	3	0						
校外實習(二)	Extracurricular Internship (II)	6	0	6						
半導體物理導論	Introduction to Semiconductor Physics	3	3	0						
半導體薄膜與製程	Semiconductor Thin Films and Processes	3	3	0						
非傳統加工	Non-Traditional Machining Processes				3	3	0			
製程規劃	Manufacturing Process Planning				3	3	0			
精密加工技術	Precision Machining				3	3	0			
可程式控制器	Programmable Logic Controller Principles and Applications				3	1	2			
創新產品開發設計	Innovative Product Development and Design				3	3	0			
校外實習(三)	Extracurricular Internship (III)				6	0	6			
半導體元件導論	Introduction to Semiconductor Components				3	3	0			
半導體封裝導論	Introduction to Semiconductor Packaging				3	3	0			

學分學時總數計算表																				
第一學年					第二	學	年			第三	第四學年									
	上學期 下學期			上	學期	下	學期	上學期 下學期					上	上學期		下學期				
	學分	_	時質習	學分	學時實習		學分	學時實習	學分	學時實習		學分	學時實習	學分	學時實習		學分	學時實習		學時實習
必修科目學分/時數	13	24		21	27	必修科目學分/ 時數	25	25	18	18	必修科目學分/時 數	18	18	3	3	必修科目學分/ 時數	3	3	0	0
最低選修科目學分/時 數	0	0		0	0	最低選修科目學 分/時數	0	0	0	0	最低選修科目學 分/時數	0	0	9	0	最低選修科目 學分/時數	9	9	12	12
總學分數及時數累計	13	24		21	27	總學分數及時數 累計	25	25	18	18	總學分數及時數 累計	18	18	12	112	總學分數及時 數累計	12	12	12	12

備註 Note:

- 一、畢業至少應修滿 131 學分【必修 101 學分,專業選修 30 學分】。
 - Students should complete at least 131 credits before graduation, includes 101 required credits, 30 professional elective credits.
- 二、學生須於一年級第二學期結束前通過華語文能力測驗(TOCFL)A2(含)級以上測驗。如未能通過華語文能力 A2(含)級以上測驗者,則逕予退學。

Students must pass the Chinese Language Proficiency Test of A2 (inclusive) or above before the end of the second semester of the first grade. Those who fail to pass the Chinese language proficiency test of A2 (included) or above will be expelled from the school.

三、為因應法規變更、評鑑建議或政府計畫規定等外在因素,本系保有調整學分計畫之權利。若有修訂,將於學期開始前公告,並明確說明修訂內容、影響範圍及相關配套措施,以保障學生權益。

The department reserves the right to adjust the curriculum in response to external factors such as changes in regulations, suggestions of evaluation and accreditation, or government program regulations. If there are any revisions, will be announced before the start of the semester, and the revised content, scope of impact, and related supporting measures will be clearly stated to protect the rights and interests of students.